

107 年度科技部「矽光子及積體電路」專案研究計畫

業界合作意願書

本企業_____與計畫主持人_____合作，
參與科技部研究計畫（計畫名稱：_____），對研究
主題及產出有高度興趣，願意參與本研究計畫。

合作企業統一編號：

主要營業項目：

單位：

職稱：

電話：

E-mail：

合作企業代表：_____（簽章）

中華民國 ____ 年 ____ 月 ____ 日

規劃與業界合作之工作項目與內容說明

第一年:

第二年:

第三年:

第四年: